

证券代码：300327

证券简称：中颖电子

中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号 2021-024

投资者来访类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	信达电子 李少青、刘志来；申万宏源 袁航；标朴投资 周明巍；华夏未来资本 丁鑫；恒越基金 赵炯；长城财富保险资管 秦晋；华创资管 孙云；建信保险资管 岳小琳；摩根华鑫基金 李扬；长城基金 杨维维；华创证券 游风；信达澳银基金 张凯；安信基金 张天麒；华泰证券 吕兰兰、周泰辰、姚逊宇；弘尚资管 许东；鹏华基金 唐宁；观景资产 张陈凯；太平基金 周发祥
时间	2021 年 9 月 23 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	潘一德、徐洁敏
投资者关系活动主要内容介绍	首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市场和公司未来发展的展望。然后现场回答了提问，具体内容如下： 1、来宾问：公司产能、产品价格和毛利率的情况？ 潘一德：公司已经落实长期产能保障策略，公司致力维持与上游代工伙伴的紧密合作，在采购规模及未来的发展前景上，也能得到上游供应商的一定程度重视，公司有能力保障取得上游代工产能的逐步增长，预期今年产能会逐季略有增加。在可预见的一两年内，公司取得的上游的产能，能保障一定的持续增长。 今年在产业产能供应不足的大背景下，上游供应商有多次涨价，为了取得更多晶圆产能，公司也适当向下游传导成本的上升。随着上游代工厂持续不停调涨代工价格，公司大部分产品从年初起迄今提高过 1-2 次售价，公司基本有能力保持产品维持在合理的毛利率水平。

2、来宾问：公司的库存情况？

潘一德：公司家电芯片的销售增速受产能限制，目前库存成品很少，大部分产品都是卖掉的，主要是半成品。公司和经销商基本没库存，公司家电的终端客户可能会有一些成品库存，但是我们难以完全掌握。

3、来宾问：公司的研发人员情况？

潘一德：公司员工近 8 成为研发人员，公司研发人员的薪资属行业中等偏上。目前人才竞争确实十分激烈，公司人员也有流动，公司将在西安、合肥扩大研发人员的计划，预期未来研发人员仍会逐步增长。

4、来宾问：公司锂电池管理芯片的情况？

潘一德：公司锂电池管理芯片涉及产品的安全性，技术壁垒高。中美贸易摩擦加速了客户对锂电池管理芯片进口替代的意愿。在手机及 TWS 耳机的锂电池管理应用上已经在国内多家品牌大厂量产，在笔记本电脑的应用上，也得到品牌大厂的认可和采用，正处于国产替代市占份额扩充的成长初期。公司锂电池管理芯片产品已从后装市场逐渐进入了前装市场。

动力锂电池管理芯多用于电动自行车、扫地机器人、电动工具等；随着锂电池管理芯片的快充应用越来越多、新国标电力自行车及储能市场的快速成长，整体锂电池管理芯片市场呈现蓬勃发展。

5、来宾问：公司汽车电子的研发情况？

潘一德：公司长期持续准备汽车电子的相关技术，目前主要研发车身控制 MCU 部分，公司正在加紧研发产品。公司现有空调控制、变频马达控制、锂电池管理等芯片相关技术积累，各产品线长期也可以往汽车电子领域方向延伸。

6、来宾问：公司 MCU 产品情况？

潘一德：家电芯片的销售增速受产能限制，公司的变频冰箱、洗衣机应用已量产，变频空调的客户要求产品的稳定性高，验证时间长，现在客户已在小批量生产中。家电的主要竞争对手在境外，公司传统 MCU 产品的应用持续扩展，渗透率提升。

公司秉承本土化、差异化的经营理念，强调贴近客户，深刻理解专业应用领域用户的需求，主要专注于细分市场，开发行业订制的 ASSP 产品，集成外围分立元器件，降低 BOM 成本。和国内新兴崛起的竞争者相比，公司产品在可靠

性、品牌认可、供货能力等方面具有一定优势。公司在销售芯片的同时，还会为客户提供开发工具。

公司产品的生命周期长。公司成为白色家电生产厂家国产 MCU 的主要选择。在未来的一段时间内，公司在白色家电 MCU 的市占率可望持续提高。

7、来宾问：公司 IOT 研发情况？

潘一德：公司已有的 MCU+蓝牙方案，已用于医疗应用领域，现在开发的 WiFi 技术主要以低工耗，高兼容，高可靠，传输距离长为主。公司现有的 32 位 MCU 主要用于变频空调领域及物联网应用。对于智能家居，公司 MCU 芯片会预留端口，让客户通过 WiFi 或蓝牙实现家电的互联互通，希望未来能提供客户 MCU 加无线传输整合的方案。

8、来宾问：公司 AMOLED 产品情况？

潘一德：AMOLED 显示驱动芯片的手机屏需求成长趋势明确，国内市场规模扩大，可望迎来更多的销售增长机会。产品主要用于手机屏、手表、自拍杆等。

AMOLED 显示驱动芯片，主要市场为韩系及台系厂商所主导，有单一产品量大，毛利率偏低的市场特性，公司掌握自有核心技术，目前产品主要与台系厂商进行市场化竞争。公司计划在年底前推出前装品牌市场规格要求的手机屏 AMOLED 显示驱动芯片，实际仍视研发进度而定。

9、来宾问：公司的封装有无瓶颈？

潘一德：封装厂的生产周期延长比较明显。公司已自购了测试机台，可保证测试环节基本不会成为产能瓶颈。

10、来宾问：公司销售人员情况？

潘一德：公司销售人员约 6%左右，由于公司属于轻资产型的公司，产品一般是通过经销商的销售模式，大多数情况下，公司直接提供大客户工程服务。只有少部分显示驱动芯片是直销的。

11、来宾问：公司以后的风险点是什么？

潘一德：公司不断完善公司治理，培养各阶层专业经理人梯队，汇集了一批集成电路领域的优秀人才，公司产品以高性价比、高可靠性、低不良率、高直通率为核心竞争力，在产品线规划布局上，重视短、中、长期交替互相补充，

	重视技术积累。公司的主要产品，长期趋势处于正面发展的方向，在国产替代率达到较高水平之前业绩增长的风险不大。
附件清单 (如有)	
日期	2021 年 9 月 23 日